

### 特点:

- 频率范围: 20~1000MHz
- 增益: 15dB
- P<sub>-1</sub>: 20dBm
- 工作电压及电流: +5V@60mA
- 封装: SM08A
- 工作温度: -55℃~+85℃
- 产品执行标准为 GJB8481-2015

### 图片:



### 性能参数: (TA=+25℃, 50Ω系统)

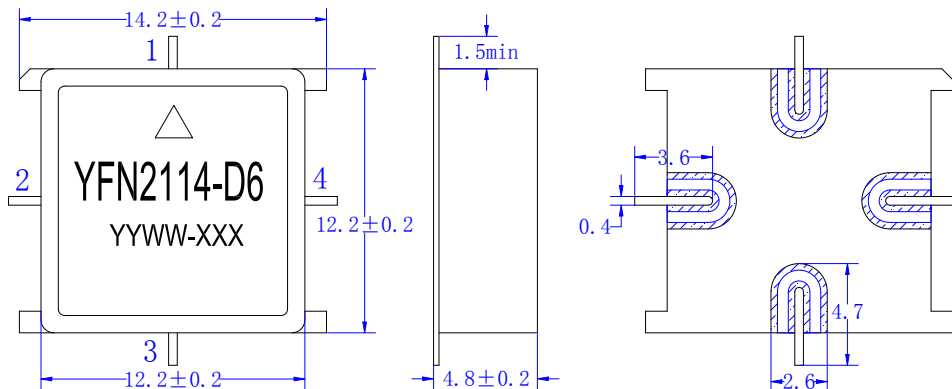
参数名称	符号	测试条件	参数值			单位	备注
			MIN	TYP	MAX		
频率范围	f	V <sub>cc</sub> =+5.0V f=20~1000MHz P <sub>in</sub> ≤-20dBm	20		1000	MHz	
功率增益	G <sub>P</sub>		14	15		dB	
增益平坦度	ΔG <sub>P</sub>			0.5	1.0	dB	
输入驻波比	VSWR <sub>i</sub>			1.5:1	2.0:1		
输出驻波比	VSWR <sub>o</sub>			1.5:1	2.0:1		
噪声系数	NF				1.0	1.5	dB
输出-1dB 压缩点	P <sub>-1dB</sub>	V <sub>cc</sub> =+5.0V, P <sub>in</sub> ≤-20dBm	20			dBm	
工作电压	V <sub>CC</sub>		+4.75	+5.0	+5.25	V	
电源电流	I <sub>CC</sub>	V <sub>cc</sub> =+5.0V, P <sub>in</sub> ≤-20dBm		60	70	mA	
质量	m				5	g	

### 极限参数表:

参数名称	极限值	单位	参数名称	极限值	单位
电源电压	+6	V	贮存温度	-55~+125	℃
输入射频功率	10	dBm			

### 封装外形图:

单位: mm



注: 1、未标注公差按 GB/T1804—2000 规定, 公差等级 f;

2、产品本体采用氧化铝陶瓷金属封装, 引脚及底部焊盘表面镀镍金 (Ni 1.2~8.9μm, Au1.2~5.7μm);

3、产品标识采用激光刻字, 完成后盖板和底座进行平行缝焊处理。

**字符标志:**

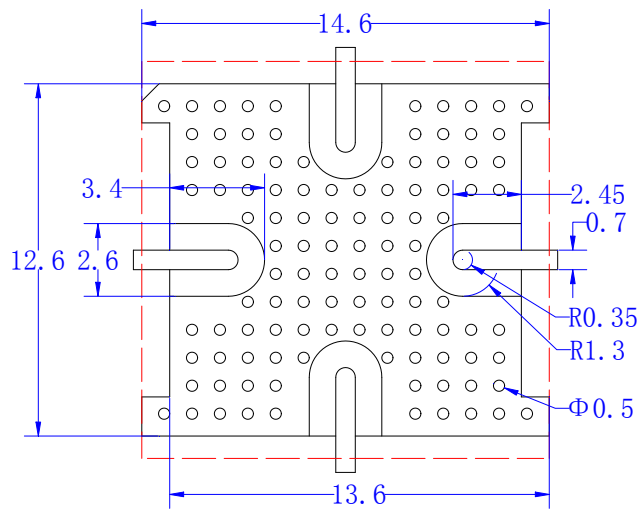
YFN2114-D6	产品型号
YYWW	批次号
XXX	序列号

**引脚定义:**

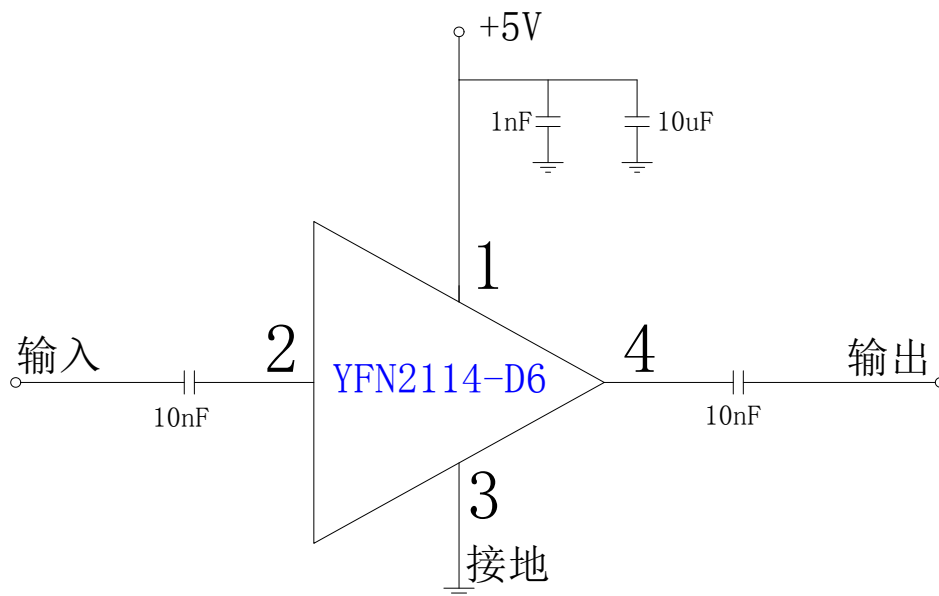
引脚	定义	备注
1	Vcc	电源电压端
2	RF IN	射频输入端, AC 耦合
3	GND	接地端
4	RF OUT	射频输出端, AC 耦合

**推荐焊盘:**

单位: mm

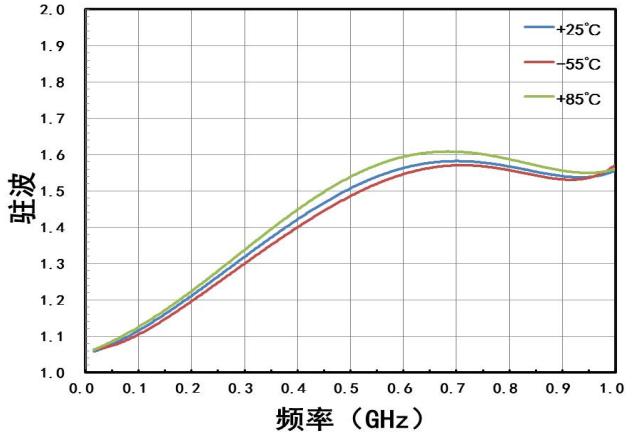


**推荐使用电路:**

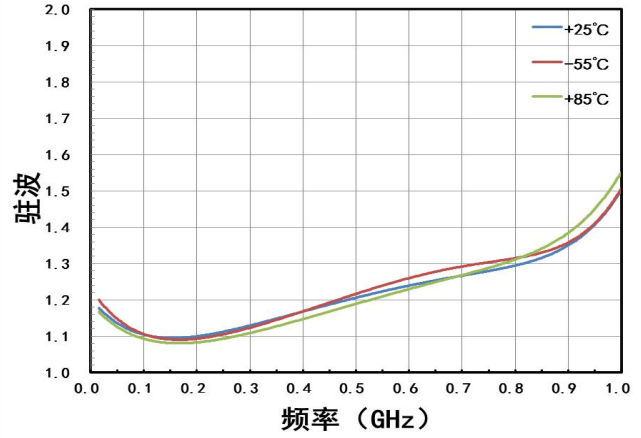


典型测试曲线:

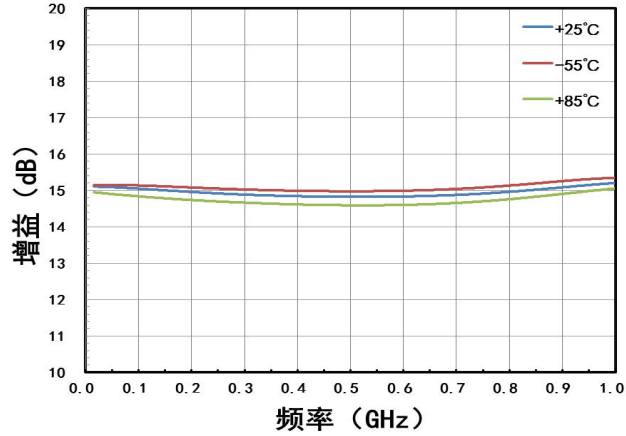
输入驻波VS. 温度 (+5V)



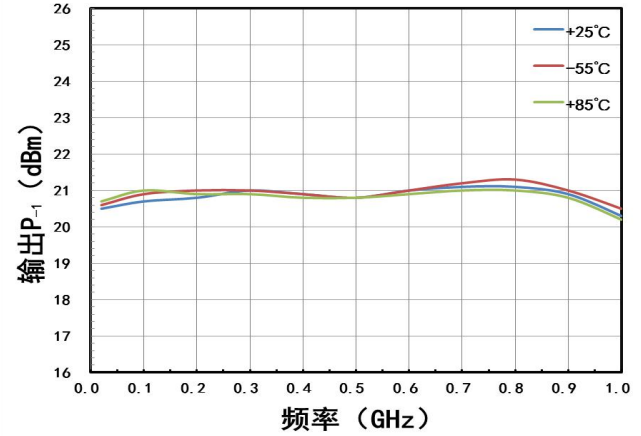
输出驻波VS. 温度 (+5V)



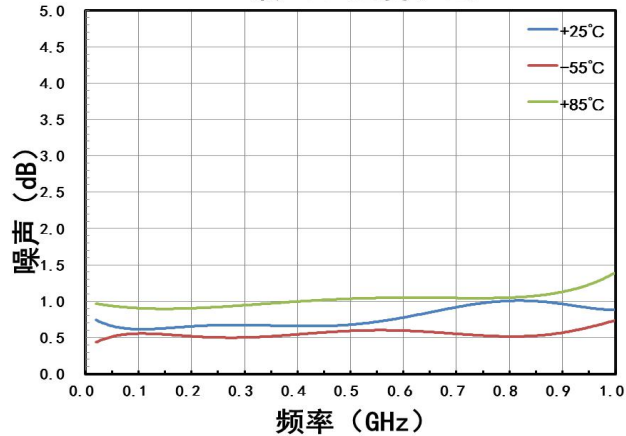
增益VS. 温度 (+5V)



输出P<sub>-1</sub>VS. 温度 (+5V)

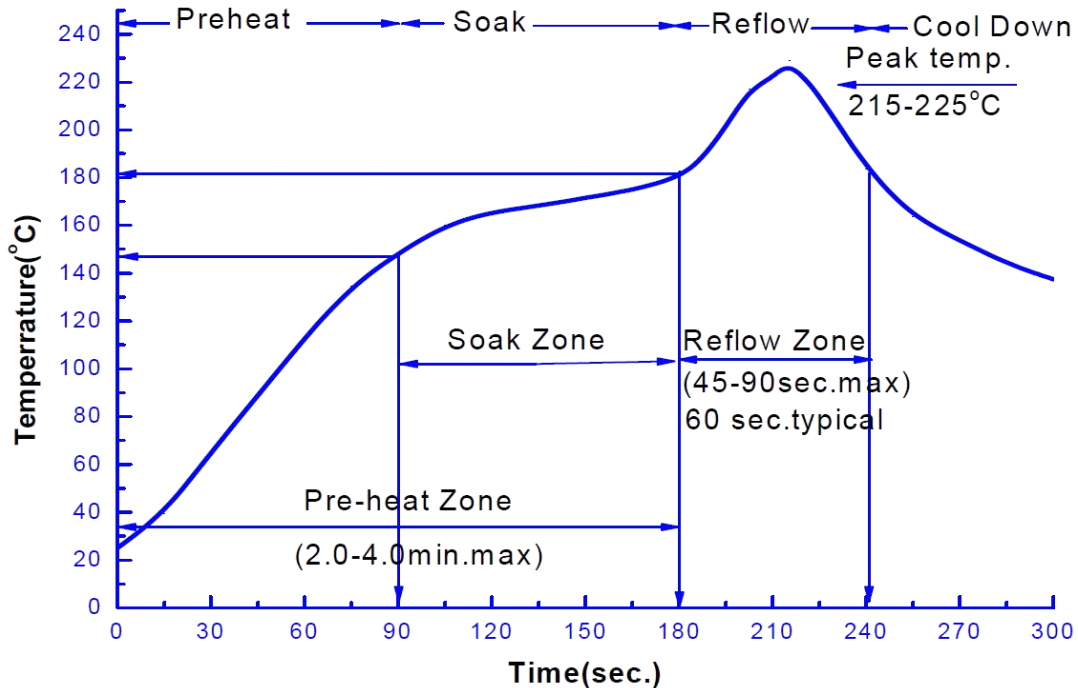


噪声VS. 温度 (+5V)



### 产品使用注意事项:

- 1.产品属于静电敏感器件，产品在运输、装配使用过程中请注意静电防护；
- 2.产品使用时请保证接地良好（GND 引脚和底部金属化区域）；
- 3.产品推荐采用 SMT 工艺贴片使用，采用 Sn63/Pb37 锡膏，熔点 183℃回流焊接，回流温度推荐曲线。



此图为推荐回流温度曲线，因基板及回流焊设备性能不同而有所差异。请依据使用的基板与回流设备确认实际温度曲线，实测回流基板温度不得超过 230℃。

- 4.如特殊情况需采用手工焊接，烙铁温度 350℃，焊接时间不超过 3 秒；回流及手工焊接次数不大于 3 次。
5. 产品在存储时需采用防静电托盘或防静电袋进行密封包装，存放条件：温度 10~35℃，湿度 35~65%RH；对于需长期储存（超过半年）产品尽量在充氮干燥环境下存放。
6. 客户在产品应用时应结合实际环境考虑是否对产品进行防护处理。对有盐雾防腐等要求的环境，客户在对产品焊接及清洗完成后，应对宇熙产品进行三防喷涂处理，以提高产品耐环境适应性能力。